JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10253995 A

(43) Date of publication of application: 25.09.98

(51) Int. CI

G02F 1/15 C03C 27/12

(21) Application number: 09053111

(22) Date of filing: 07.03.97

(71) Applicant:

CENTRAL GLASS CO LTD

(72) Inventor:

NAKASE KIYOSHI TAO MASATO

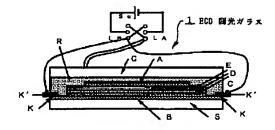
(54) LIGHT-CONTROLLING GLASS, AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to have uniform coloring/color fading, excellent appearance, durability and stability, and to improve the productivity and to reduce the cost, by using a middle film for a paired glass, and bringing a low resistance electrode part into direct contact with the end side part of an upper and lower transparent electrode layers abutting on a bus bar part.

SOLUTION: An ECD is manufactured by forming a lower part ITO electrode layer B, further, a reversible electrolytic oxidized layer C, a tantalum oxide ion conductive layer D, a tungsten oxide layer E and an upper part ITO electrode layer A on the whole surface of an element substrate S made of glass by DC spattering. Then, a sheet R being the middle film for sticking glass is cut out, and is placed on the prescribed position (position of low resistance electrode part for transparent electrode = bus bar K) of the sheet R so than an embossed copper film coincides with it, and the copper foil is stuck to the sheet R instantly. Then, respective external wiring LA, LB are bonded to the connection parts K' of the bus bar K of the electrode layer, and the ECD light- controlling glass 1 is manufactured.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO





(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-253995

(43)公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51) Int.Cl.⁶

酸別記号 502

G02F 1/15

C03C 27/12

FΙ

G02F 1/15

C 0 3 C 27/12

502

L

N

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特顧平9-53111

(22)出願日

平成9年(1997)3月7日

(71) 出願人 000002200

セントラル硝子株式会社

山口県宇部市大字沖宇部5253番地

(72)発明者 中瀬 喜好

三重県松阪市大口町1510 セントラル硝子

株式会社硝子研究所内

(72)発明者 田尾 正人

三重県松阪市大口町1510 セントラル硝子

株式会社硝子研究所内

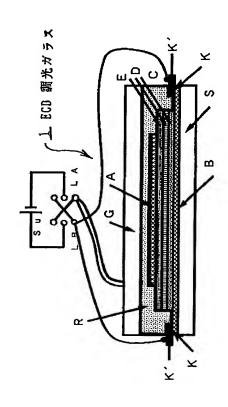
(74)代理人 弁理士 西 義之

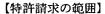
(54) 【発明の名称】 調光ガラスおよびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 着消色が均一で良好な外観をより長く持続で き、より長期的な耐久性を備え、長期的安定性に優れる 調光ガラスを生産性をより向上しコストダウンを図り、 製造する。

【解決手段】 少なくともエレクトロクロミック層とこ れを挟む一対の透明電極層とからなるエレクトロクロミ ック素子を素子基板表面に形成した調光ガラスにおい て、前記透明電極層上のバスバー部に当たる低抵抗電極 部に対応する位置に予め低抵抗電極部を設けた合わせガ ラス用中間膜を透明電極層上に重ねる。





少なくともエレクトロクロミック層とこ 【請求項1】 れを挟む一対の透明電極層とからなるエレクトロクロミ ック素子を素子基板表面に形成した調光ガラスにおい て、前記透明電極層上のバスバー部に当たる低抵抗電極 部に対応する位置に予め低抵抗電極部を設けた合わせガ ラス用中間膜を透明電極層上に重ねてなることを特徴と する調光ガラス。

前記低抵抗電極部が素子基板表面の端部 【請求項2】 の位置の前記透明電極層上に形成された導電性の箔また はワイヤーからなり、その箔またはワイヤーの一部が前 記合わせガラス用中間膜の縁から外側へ突出しており、 リード線との接続部となることを特徴とする請求項1記 載の調光ガラス。

【請求項3】 一対の透明電極層の重なりがある領域の 上部透明電極層上に、前記低抵抗電極部に接続された導 電性のワイヤーを配設してなることを特徴とする請求項 1乃至2記載の調光ガラス。

少なくともエレクトロクロミック層とこ 【請求項4】 れを挟む一対の透明電極層とからなるエレクトロクロミ ック素子を素子基板表面に形成した調光ガラスの製造方 法において、前記透明電極層上にバスバー部に当たる低 抵抗電極部を設けるために、該低抵抗電極部に対応する 位置に予め低抵抗電極部を設けた合わせガラス用中間膜 を前記透明電極層上に重ねることを特徴とする調光ガラ スの製造方法。

前記低抵抗電極部を、熱によって合わせ 【請求項5】 ガラス用中間膜に貼着することを特徴とする請求項4記 載の調光ガラスの製造方法。

前記合わせガラス用中間膜が、可塑化ポ 【請求項6】 リビニールブチラール、もしくは変成エチレンビニール

> $H_90 \rightarrow H^+ + 0H^-$ (WO₃ 膜=陰極側) WO₃ +nH⁺ +ne⁻ →HnWO₃ 青着色 無色透明

(絶縁膜=陽極側) $0H^- \rightarrow (1/2)H_20 + (1/4)0_2 \uparrow + (1/2)e^-$

その他にECD として知られているものは、上部電極と下 部電極の間に、還元着色性EC層(例えばWOg)、イオン 導電層(例えば酸化タンタル)、可逆的電解酸化層(例 えば酸化または水酸化イリジウム)が積層(EC三層)さ れ、両電極間に所定の電圧を印加できる構造となってい る。

【0007】ところで、EC層を直接または間接的に挟む 一対の電極層は、EC層の着消色を外部に見せるために少 なくとも一方は透明でなければならない。特に透過型の ECDの場合には両電極層とも透明でなければならない。

【0008】透明な電極材料としては、現在のところSn 0₂、In₂0₃ 、ITO (In₂0₃ とSnO₂の混合物)、ZnO 等が 知られているが、これらの材料は比較的透明度が悪いた めに薄くせねばならず、この理由及びその他の理由から ECD は基板 (例えばガラス板やプラスチック板) の上に

アセテートであることを特徴とする請求項4乃至5記載 の調光ガラスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロクロミ ック素子を基板表面に形成した調光ガラスおよびその製 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】電圧を印加すると可逆的に電解酸化また は還元反応が起こり、可逆的に着消色する現象をエレク トロクロミズムという。

【0003】このような現象を示すエレクトロクロミッ ク(以下、ECと略す)物質を用いて、電圧操作により着 消色するEC素子(以下、ECD と略す)を作り、このECD を光量制御素子(例えば調光ガラスや防眩ミラー等)や 7セグメントを利用した数字表示素子に利用しようとす る試みは、20年以上前から行われている。

【0004】例えば、ガラス基板の上に透明電極膜(陰 極)、三酸化タングステン薄膜、二酸化ケイ素のような 絶縁膜、電極膜(陽極)を順次積層してなるECD (特公 昭52-46098 号参照) が全固体型ECD として知られてい る。

【0005】このECD に電圧を印加すると三酸化タング ステン(WO3)薄膜が青色に着色する。その後、このEC D に逆の電圧を印加すると、WO3 薄膜の青色が消えて、 無色になる。この着消色する機構は詳しくは解明されて いないが、WO3 薄膜及び絶縁膜(イオン導電層)中に含 まれる少量の水分がWO3 の着消色を支配していると理解 されている。

【0006】着色の反応式は、以下のように推定されて いる。

形成されるのが普通である。

【0009】また、ECD は用途によって、素子を保護す るための封止基板を素子基板と対向するように配置し、 例えばエポキシ樹脂等を用いて密封封止して用いられ る。ところで、電気素子を用いる調光ガラスは、ECD や 液晶を利用するものなど、種々提案されており、液晶で は既に実用化されている。

【0010】ECD を用いる調光ガラスは、実用化は遅れ ているが、透過光のエネルギーを連続的に制御でき、し かも視角依存性がない等の液晶にはない優れた特性を有 する。ECD には、材料(主に電解質)の形態として溶液 型、ゲル型、全固体型等の種類がある。

【0011】建築用、車両用窓材等をターゲットにした 調光ガラスの大型化が要請され、ECD においても大型化 の研究開発が進められているが、EC着色層、電解質層、

電極層等をすべて薄膜状に連続的に形成する全固体型ECDは、貼り合わせや液状材料密封といった工程が不要であり、工程上最も大型化が容易と考えられている。

【0012】ECD 調光ガラスの電極層には透明導電膜が用いられる。現在、透明導電膜に多く使われているのはITO であるが、2n0 や $Sn0_2$ 等その他の材料も検討されている。これらの材料を使用して一対の透明電極層(上部と下部の透明膜)が、通常、真空蒸着法やスパッタリング法等で基板上に形成されるが、金属電極層と比較するとかなり高抵抗である。

【0013】前記上部、下部透明電極層とも外部電源から電圧を印加するために外部配線との接続が必要である。しかし、上下部透明電極層に対応して外部配線との接続するための電極として透明電極部(バスバー部:上下部透明電極層の適宜対向辺に対に)を使用した場合には、透明電極部が外部配線に比べて高抵抗であるので、透明電極部に重ねて(即ち、接触させて)低抵抗の電極部分を設ける。通常は、基板表面端部に位置する透明電極層の端辺部に、帯状に低抵抗透明電極部を設ける(例えば、金属製クリップを装着する)。

【0014】また、ECD 調光ガラスは素子劣化を防ぐために封止樹脂(例えばエポキシ樹脂)及び封止基板により封止されて用いられる。本出願人が既に出願した発明に係わる特開平6-167724号公報では、調光ガラスの製造方法を記載し、少なくともエレクトロクロミック層とこれを挟む一対の透明電極層とからなるエレクトロクロミック素子を素子基板表面に形成した調光ガラスの製造方法において、素子基板表面の端部及び内部に位置する前記透明電極層上に低抵抗電極部を設け、この素子基板を合わせガラス用中間膜および封止基板により封止したことを開示した。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】ECD 調光ガラスの大型化には種々の技術的問題を伴うが、その中の大きな問題点に不均一な着消色がある。この不均一な着消色は、ECD 着色時に時間が経過しても着色濃度がECD の全面で一定とならないで濃淡差(色むら)ができ、また消色時にも濃淡差(色むら)が目立つ現象であり、外観不良の他、耐久性低下の原因となる。

【0016】また、別の問題点に封止の生産性が悪いことがある。硬化する前の封止樹脂は液状であり、ECD 調光ガラスの光学歪みや素子劣化を防ぐために、素子面全体に均一な厚さで封止樹脂を硬化させる必要がある。この均一な厚さの達成には、封止樹脂量、加圧力及び加圧力分布の適切な調整を要する。

【0017】例えば、基板面からはみだす程封止樹脂量を十分に多くすると、均一厚さのための加圧力及び加圧力分布の調整は比較的容易となるが、はみだした樹脂を除去する工程が必要になる。また、基板面からはみださないように封止樹脂量を少なくすると、はみだした樹脂

を除去する工程が不要になるが、均一厚さのための加圧 力及び加圧力分布の調整が非常に困難となり、均一厚さ を実現できないか、または調整に多大の時間を要するこ とになる。

【0018】また、本出願人が既に出願した発明に係わる特開平6-167724号公報に記載の調光ガラスの製造方法では、着消色が均一で外観や耐久性及び生産性を向上せしめることができたものの、例えば上下電極部(バスバー部)に低抵抗電極部を粘着テープで適宜貼り付けていたが、貼り付け作業に時間がかかることがあり、また長期の使用では該貼り付け部の接着が剥離する現象が起こることがあって、外観不良になるばかりか、前記上下電極部と前記低抵抗電極部との接触が悪くなり、接触抵抗が高くなって着消色時とも応答性が低下することがあり、さらなる耐久性が望まれるものであった。

【0019】本発明の目的は、着消色が均一で良好な外観をより長く持続でき、より長期的な耐久性を備え、長期的安定性に優れる調光ガラスを生産性をより向上しコストダウンを図り、製造することにある。

[0020]

【課題を解決するための手段】ECD 調光ガラスの大型化に伴って、基板表面端部に位置する透明電極層上に設けた低抵抗電極部の間隔が増大する。図7は、ECD 調光ガラスの概略断面図であり、図9は、従来のECD 調光ガラスであって、基板表面端部に位置する透明電極層上に設けた低抵抗電極部(例えば金属製クリップ)H1, H2の間隔が大きいECDに電圧を印加した場合における電流Iの流れる様子を模式的に示した図〔図9(a)〕、およびこれによるECD 調光ガラスにおける着色状況を示した図〔図9(b)〕である。

【0021】ECD が大型化するに従い、透明電極層の抵抗が増大してECD の内部方向への抵抗よりも大きくなるので、図9に示すように、電流Iの大部分は、透明電極層の一端から比較的低抵抗で流れやすいECD 内部に流れ込んでしまい、その結果、低抵抗電極部H1に近い部分では早く濃く着色するが、低抵抗電極部H1から離れた中央部から他端にかけては、ほとんど電流が流れず、着色が非常に遅く薄くなり、特に大型のECD において、この傾向が著しいことが判った。

【0022】また、消色時も、着色時に比べれば不均一の傾向は少ないものの、同様の原因で不均一に消色することが判った。なお、図6は、従来のECD 調光ガラス4の基板の4辺端部に4本の導電性クリップH を装着した場合の状態を示す概略平面図である。

【0023】従って、図8に示すような均等な電流が流れ、均一に着消色する大型ECDとするためには、透明電極層の抵抗をECDの内部抵抗程度に小さくすればよいことが判った。

【0024】透明電極層の抵抗を小さくするためには、 低抵抗の電極材料を使用すれば良いが、現状の透明電極 材料(ITO 、2n0 、 $8n0_2$ 等)では、この要求を充分に満たすことができない。

【0025】本発明者らは、低抵抗の電極部の形成方法について、ECD 調光ガラスの封止に合わせガラス用中間膜を使用し、該中間膜に低抵抗電極部を直接熱着し、該低抵抗電極部と前記したバスバー部(上下電極部)に当たる上下透明電極層の端辺部とをそれぞれ直接接触させるようにすると、長期の使用でも前記した剥離現象が起こることもなく、着消色が均一で良好な外観をより長く持続でき、より長期的な耐久性を備え、長期的安定性に優れる調光ガラスを製造することができ、封止の生産性がより向上しコストダウンができることを見出した。

【0026】本発明は、少なくともエレクトロクロミック層とこれを挟む一対の透明電極層とからなるエレクトロクロミック素子を素子基板表面に形成した調光ガラスにおいて、前記透明電極層上のバスバー部に当たる低抵抗電極部に対応する位置に予め低抵抗電極部を設けた合わせガラス用中間膜を透明電極層上に重ねてなることを特徴とする調光ガラス、また、前記低抵抗電極部が素子基板表面の端部の位置の前記透明電極層上に形成された導電性の箔またはワイヤーからなり、その箔またはワイヤーの一部が前記合わせガラス用中間膜の縁から外側へ突出しており、リード線との接続部となることを特徴とする上述した調光ガラス、また、一対の透明電極層の重なりがある領域の上部透明電極層上に、前記低抵抗電極部に接続された導電性のワイヤーを配設してなることを特徴とする上述した調光ガラスを提供するものである。

【0027】さらに、本発明は、少なくともエレクトロクロミック層とこれを挟む一対の透明電極層とからなるエレクトロクロミック素子を素子基板表面に形成した調光ガラスの製造方法において、前記透明電極層上にバスバー部に当たる低抵抗電極部を設けるために、該低抵抗電極部に対応する位置に予め低抵抗電極部を設けた合わせガラス用中間膜を前記透明電極層上に重ねることを特徴とする調光ガラスの製造方法を提供するものである前記低抵抗電極部を、熱によって合わせガラス用中間膜に貼着するとよく、前記熱の温度が、約80℃以上150℃以下程度であると好ましい。

【0028】また、前記貼着する手段は、通電による発熱、あるいはハンダゴテまたはこれに類するものでの熱であるとよい。さらに、前記合わせガラス用中間膜は、可塑化ポリビニールブチラール、もしくは変成エチレンビニールアセテートが好ましい。

[0029]

【発明の実施の形態】本発明の調光ガラスでは、基板表面端部に位置する透明電極層上だけでなく、透明電極層パターンの輪郭線よりも内側の基板表面内部の上部透明電極層上に低抵抗電極部(以後、この低抵抗電極部を補助バスバーとも呼ぶ)を設けることにより、上下透明電極層上の低抵抗電極部間隔を低減して透明電極層の抵抗

をECDの内部抵抗に近づけることができる。

【0030】その結果、ECD に電圧を印加した時の電流 Iは、図8に示すようにECD 内部方向だけでなく上部透 明電極層の水平方向にも充分に流れ、しかも比較的低抵 抗のECD 内部に於ける着色の拡散効果があるので、ECD 全面に渡って均一に着色させることができる。

【0031】バスバーの材料としては、例えば金、銀、アルミニウム、銅、白金、クロム、スズ、亜鉛、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、ステンレス等の金属ワイヤー、金属箔及び金属薄膜または導電性ペースト等が使用できる。

【0032】シートR の端部に設けたバスバーの一部を合わせガラス用中間膜の端縁から外側へ突出させてリード線との接続部とすることが好ましく、金属箔または金属ワイヤーを用いる場合は、その長さ方向に対して端部を外側へ90°折り曲げるだけでよい。

【0033】ところで、バスバーの長さとしては、基板の一辺の長さいっぱいと長すぎると着色時にコーナー4箇所の透過率が下がりすぎ、全体のバランスがとれなくなるため、基板の一辺の長さより短めとすることが好ましい(恐らく他の場所と比べ、通電による電圧降下の影響が少ない)。最適のバスバーの長さは、印加電圧、IT0の抵抗、ECDの抵抗、ECDの形状、使用温度などの複雑な要因を考慮して適宜決める。

【0034】なお、図7~9に見られるように、バスバーが下部ITO 電極部、上部ITO 電極部ともに1本(1辺)づつであれば、バスバーの長さを短くする必要はない。また、本発明にかかる合わせガラス用中間膜には、例えば可塑化PVB(ポリビニールブチラール)または変成EVA(エチレンビニールアセテート)が好ましいが、これらに類するものであれば特に限定されるものではない。

【0035】本発明に於けるECD の積層構造は、特にどれと限定されるものではないが、固体型ECD の構造としては、例えば①電極層/EC層(酸化発色膜または還元発色膜)/イオン導電層/電極層のような4層構造、ならびに②電極層/還元着色型EC層/イオン導電層/可逆的電解酸化層/電極層のような5層構造〔図7〕が挙げられる。

【0036】還元着色型EC層としては、一般にW0 $_3$,Mn 0_3 , V_20_5 等が使用される。イオン導電層としては、例えば酸化ケイ素、酸化タンタル、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ニオブ、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化ランタン、フッ化マグネシウム等が使用される。また、イオン導電層は、電子に対して絶縁体であるが、プロトン(H^+) 及びヒドロキシイオン(OH^-) に対しては良導体となる。EC層の着消色反応にはカチオンが必要とされ、 H^+ や Li^+ をEC層その他に含有させる必要がある。 H^+ は、初めからイオンである必要はなく、電圧が印加された時に H^+ が生じればよく、従って H^+ の

代わりに水を含有させてもよい。この水は、非常に少なくて充分であり、しばしば大気中から自然に侵入する水分でも着消色する。

【0037】可逆的電解酸化層としては、例えば酸化ないし水酸化イリジウム、同じくニッケル、同じくクロム、同じくルテニウム、同じくロジウム等が挙げられる。これらの物質は、イオン導電層または透明電極層中に分散されていてもよいし、逆にそれらを分散していてもよい。

【0038】なお、前記酸化発色膜(可逆的電解酸化層)または還元発色膜(還元着色型EC層)は、どちらを上にしても下にしてもよいが、同一の膜を上下には使用しない。

【0039】前記①の場合は、EC層とイオン導電層とは、どちらを上にしても下にしてもよい。さらに前記②の場合は、EC層に対して間にイオン導電層を挟んで(場合により酸化着色性EC層ともなる)可逆的電解酸化層(ないし触媒層)を配設してもよい。

[0040]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0041】実施例1

図 $1\sim3$ に示す約45cm $\times45$ cm \forall イズの全固体型のECD (エレクトロクロミック素子) 調光ガラス $\underline{1}$ を以下の手順で作製した。

【0042】(1) 約45cm×45cmサイズのガラス製素子基板S の表面全体にDCスパッタリングにより下部ITO 電極層B を形成した。スパッタリング時の基板加熱温度は約200℃、該ITO 電極層の膜厚は約1000Å、該ITO 電極層のシート抵抗は約25Ω/口であった。

【0043】(2) 図2と3に示すように、フォトエッチングにより上記下部ITO 電極層の両側B',B''の領域のIT 0 電極層を除去した。なお、ITO をマスク蒸着することにより直接にこれらのパターンを形成してもよい。

【0044】(3) DCスパッタリングにより酸化イリジウムと酸化スズとの混合物からなる可逆的電解酸化層C、酸化タンタルのイオン導電層D、酸化タングステン層Eを順次形成した。

【0045】(4) DCスパッタリングにより上部ITO 電極層A を形成して、ECD を作製した。スパッタリング時の基板加熱は行わず(加熱すると先に成膜したEC層が劣化する)、上部ITO 電極層A の膜厚を約3000Åにして上部ITO 電極層A のシート抵抗が下部電極層B と同じ約25Ω/口になるようにした。

【0046】(5) 合わせガラス用中間膜であるシートR(変成EVA または可塑化PVB)を約45cm×45cmの大きさに切り出し、シートRの所定の場所〔図1~3のJ(上部透明電極用の低抵抗電極部=バスバー)、K(下部透明電極用の低抵抗電極部=バスバー)の位置〕にエンボス加工付き銅箔(厚さ10μm、巾2.5mm、長さ25mm。エ

ンボス加工がなくてもよいが、後工程の合わせ(封止)時に良好な接着が得られるため該加工があるものの方が好ましい)が一致するように置き、図4に示すように、AC7Vの電圧を約1cmの間隔の通電端子に印加し、銅箔の任意の点を押さえ、火花が僅かに発生するとともに、銅箔とシートRとは瞬間的に接着した。このような操作を銅箔1本当たり十数箇所連続して行った。

【0047】なお、銅箔とシートRとを接着する場所は、銅箔とシートRのサイズにより適宜決めればよい。また通電端子の大きさや形状についても適宜決めればよく、本実施例に限定されない。また複数の通電端子を用いてもよい。

【0048】また、銅箔は後でリード線と接続するため、シートRと接着していない部分を設け、シートRの緑から外側へ接着した銅箔の長さ方向に対し90°に折り曲げた〔図1~3におけるJ'(上部電極部=バスバーの接続部), K'(下部電極部=バスバーの接続部), K'(下部電極部=バスバーの接続部)〕。なお、印加電圧はそれほど大きくなくても銅箔とシートRとは充分接着した。印加電圧としては、ACまたはDCで約3~10Vで約1秒以内程度が好ましいものであった。また、ハンダゴテの温度は約80~150℃程度で押さえ時間は約1秒以内とほぼ瞬時の接着である。また接着力については、長期的に通電抵抗が増加する変化が起こらない低抵抗の導通が維持できるものであればよく、このような接着方法でよい。

【0049】(6) このエンボス加工付きの銅箔を上記方法で熔着的に貼り付けたシートR (EVA 膜:デュミランF300、約250 μ m) およびガラス製の封止基板G により、該銅箔熔着EVA 膜であるシートR (銅箔熔着面を素子基板のEC素子面向きとする)をEC素子付きガラス板である素子基板S (素子側を内向きとする)と封止基板Gとを、上記(4)の工程で形成した透明電極層上に銅箔がバスバーの位置になるようにサンドイッチ状に重ね、ラミネーター(プレス用)を用い、例えば約40℃、約5分で約0.1~0.5Torr または/および約85℃、約25分で0.1~5Torr 等の条件により圧着することで合わせ、冷却することによって素子を封止した。

【0050】なお、合わせによる封止の手順等、そのやり方は特に限定されない。

(7) 上部電極層及び下部電極層のバスバーJ, KのJ', k'にそれぞれ外部配線(外部配線の端子LA, LB)をボンディングしてECD 調光ガラス1を作製した。なお、前記ボンディングする位置については特に左右限定されるものではなく、また別の銅箔やワイヤー等(補助バスバー)を、例えば中央部に貼り付けたシートR(貼り付けなくてもよい)を用いる等、適宜最適な位置を選択すればよい。

【0051】この様にして作製したECD 調光ガラス<u>1</u>に前記端子LA, LBを介して駆動電源Suから約+1.5 V の消色電圧を約5分間印加して、この時のECD 調光ガラス1

の着色部全面における C光源による透過率分布を測定したところ、約 $22\sim27\%$ 程度であり、図8(b) に示すようになり、特に気になるような不均一な着色は観察されなかった。次に、約-1.5 V の消色電圧を約1分間印加すると透過率は $65\sim68\%$ 程度に回復し、消色中も気になるような色ムラは観察されなかった。

【0052】 実施例2

図5に示すように、上部透明電極(点線A)上の対向する両端部に形成した銅箔または銅薄膜のバスバーJ,Jを接続するようにニッケルメッキを施した約0.2mm φ、長さ約44.5~45mmの銅線からなる導電性のワイヤー(2点鎖線W)を約5cm 間隔で5本並べたシートRを形成して低抵抗電極部の補助バスバーとした他は、実施例1と同様にしてECD 調光ガラス2を作製した。

【0053】このECD 調光ガラス2に駆動電源Suから約 -1.5Vの消色電圧を約1分間印加して測定したリーク電流は、約-0.8mA 程度であり、実施例1の場合よりもやや増加した。リーク電流がやや大きいのは、図5に示すように、ニッケルメッキ銅線バスバーを設けた場所において圧力がかかり、上下透明電極A,Bパターンの重なり部分に何らかの影響があるためと考えられる。

【0054】該ECD 調光ガラス2に駆動電源Suから約+1.5Vの着色電圧を約2分間印加して、この時のECD 調光ガラス2の着消色部全面における C光源による透過率分布を測定したところ、約20~23%程度であり、実施例1と同様に、気になる不均一な着色は観察されなかった。

【0055】次に、約-1.5Vの消色電圧を約1分間印加すると透過率は約67~70%程度に回復し、消色中も気になるような色ムラは観察されなかった。また、応答が約2~3倍に速くなったのは、上部ITO 膜にニッケルメッキ銅線バスバーを設けたため、上部ITO 膜のシート抵抗が見かけ上下がったためである。

【0056】なお、補助電極として用いたニッケルメッキ銅線バスバーについては、これに限らず低抵抗の導体であれば何でもよいが、導体の抵抗については1本当たり約3 Ω 以下程度となるものが好ましい。3 Ω 程度以上となると上部ITO 膜への補助電極としての効果が薄れ、応答性の向上が少なくなる。さらにより好ましくは約0.5 Ω 前後程度以下(低ければ低いほどよい)である。

【0057】 実施例3

図1に示したバスバーJ、Kの銅箔を貼り付けるシートR上の位置に、銀ペーストによる銀薄膜またはマスク蒸着により銅薄膜をコーティングした他は、実施例1と同様にしてECD調光ガラスを作製した。

【0058】このECD 調光ガラスに駆動電源Suから約-1.5Vの消色電圧を約1分間印加して測定したリーク電流は、約-0.5mA 程度であった。このECD 調光ガラスに駆動電源Suから約+1.5Vの着色電圧を約5分間印加して、この時のECD 調光ガラスの着消色部全面における C光源による透過率分布を測定したところ、約21~26%程度で

あり、実施例1と同様に、気になる不均一な着色は観察されなかった。次に、約-1.5Vの消色電圧を約1分間印加すると透過率は約65~68%程度に回復し、消色中も気になる色ムラは観察されなかった。

【0059】 <u>比較例1</u>

サイズを約25cm×15cmとし、断面がコの字型で長さが約15cmのリン背銅またはステンレス製の導電性クリップH (H1、H2)を2本用意し、この導電性クリップH 2本を図9に示す様に素子基板端部の対抗する辺に装着し、これにより導電性クリップH が上部、下部各電極層の取り出し部を圧着するようにした他は、実施例1と同様にしてECD 調光ガラスを作製した。

【0060】このECD 調光ガラスに駆動電源Suから約-1.5Vの消色電圧を約0.5分間印加して測定したリーク電流は、約-0.1mA 程度であった。このECD 調光ガラスに駆動電源Suから約+1.5Vの着色電圧を約3分間印加して、この時のECD 調光ガラスの着消色部全面におけるC光源による透過率分布を測定したところ、約27~35%程度であり、図9の(a) および(b) に示すように、模式図のような不均等な電流が流れ、平面図にあるような気になる不均一な着色が観察された。次に、約-1.5Vの消色電圧を約0.5分間印加すると透過率は、約65~68%程度に回復したが、消色中もやはり気になる色ムラが観察された。

【0061】なお、本発明の調光ガラスの製造方法はECD について詳述したが、ECD 分野だけでなく、液晶(LCD)分野等これらに類する分野にも広く採用することが可能であることは言うまでもない。

【0062】比較例2

実施例1と同じ大きさで、断面がコの字型で長さが約25 cmのリン青銅またはステンレス製の導電性クリップH

(H1、H2)を4本用意し、この導電性クリップH4本を図6に示す様に素子基板端部の対抗する辺に装着し、これにより導電性クリップHが上部、下部各電極層の取り出し部を圧着するようにした他は、実施例1と同様にしてECD 調光ガラス4を作製した。

【0063】このECD 調光ガラスに駆動電源Suから約-1.5Vの消色電圧を約1分間印加して測定したリーク電流は、約-0.5mA 程度であった。このECD 調光ガラスに駆動電源Suから約+1.5Vの着色電圧を約5分間印加して、この時のECD 調光ガラスの着消色部全面における C光源による透過率分布を測定したところ、約30~38%程度であり、比較例1と同様の傾向を示す不均等な電流が流れ、気になる不均一な着色が観察された。次に、約-1.5Vの消色電圧を約1分間印加すると透過率は、約67~70%程度に回復したが、消色中もやはり気になる色ムラが観察された。

【0064】なお、本発明の調光ガラスの製造方法はECD について詳述したが、ECD 分野だけでなく、液晶(LCD)分野等これらに類する分野にも広く採用することが

可能であることは言うまでもない。

[0065]

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、合わせガラス用中間膜に電流の発熱等を利用して低抵抗電極部

(バスバー)を熱熔着させ、これを基板表面の端部の透明電極層上に圧着し、この素子基板および封止基板により封止するようにしたので、着消色が均一で良好な外観をより長く持続でき、より長期的な耐久性を備え、長期的安定性ならびに応答性が優れた調光ガラスをより生産性よく製造することができ、コストダウンを図れる。

【0066】また、一対の透明電極層の重なりがある領域に前記貼着低抵抗電極部(バスバー)に接続した前記低抵抗電極部(補助バスバー)を設けることにより、さらに応答性が格段に優れた耐久性の良好な調光ガラスを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1にかかるECD 調光ガラスの概略断面図である。

【図2】図1の実施例1にかかるECD 調光ガラスのバス バーのパターン等を示す概略平面図である。

【図3】図1の実施例1にかかるECD 調光ガラスの概略 斜視図である。

【図4】実施例1にかかる中間膜へのバスバーの接着方法を示す説明図である。

【図5】実施例2にかかるECD 調光ガラスのバスバーと補助バスバーのパターン等を示す概略平面図である。

【図6】従来の調光ガラスにおける基板端部に導電性クリップを装着した状態を示す概略平面図である。

【図7】ECD 調光ガラスの概略断面図である。

【図8】本発明にかかるECD 調光ガラスにおいて電流 I

が流れる様子を示す模式図:図8(a)、およびこれによるECD 調光ガラスの着色状況を示す平面図:図8(b)である。

【図9】比較例1のECD 調光ガラスにおいて電流 I が流れる様子を示す模式図:図9(a)、およびこれによるECD 調光ガラスの着色状況を示す平面図:図9(b)である。

【符号の説明】

<u>1</u>・・・ECD 調光ガラス

2・・・ECD 調光ガラス

4・・・ECD 調光ガラス

A・・・上部ITO 電極層

B・・・下部ITO 電極層

E・・・酸化タングステン層

D・・・イオン導電層

C・・・可逆的電解酸化層

ECD ・・エレクトロクロミック素子

R・・・シート(合わせガラス用中間膜)

S・・・素子基板

G・・・封止基板

H・・・導電性クリップ

J・・・上部透明電極用の低抵抗電極部 (バスバー)

K・・・下部透明電極用の低抵抗電極部 (バスバー)

J'・・上部電極部(バスバー)の接続部

K'・・下部電極部 (バスバー) の接続部

I・・・ECD 駆動電流

W・・・導電性のワイヤー (補助バスバーの一例)

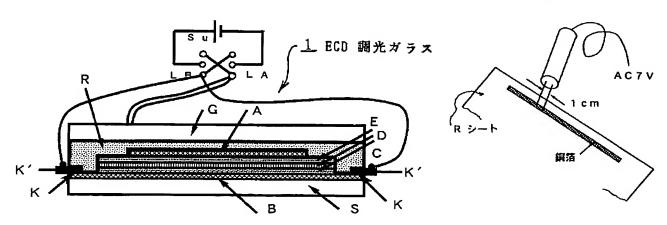
LA・・・J'からの外部配線の端子

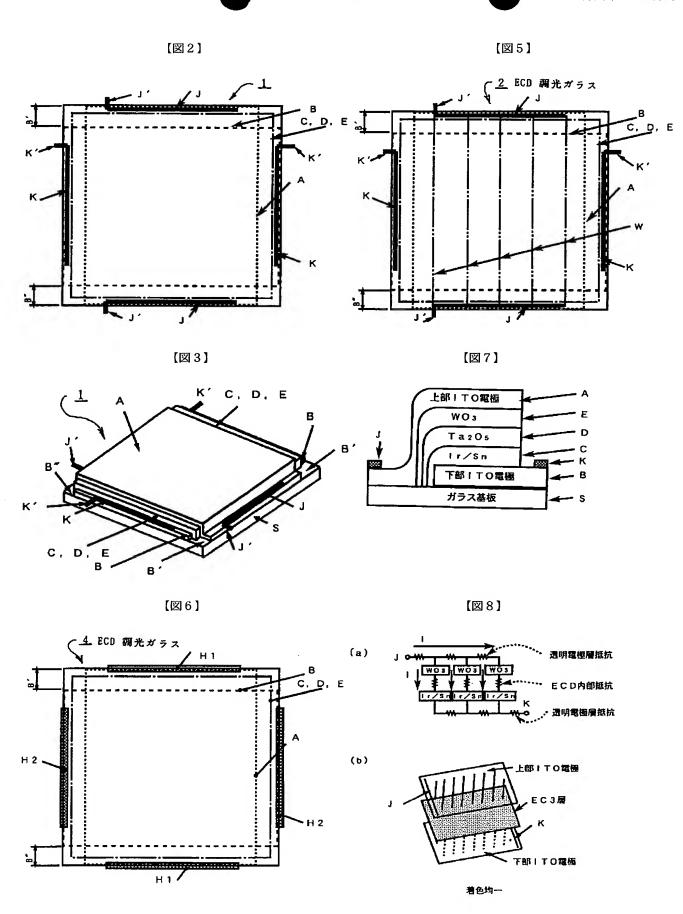
LB・・・K'からの外部配線の端子

Su···駆動電源

[図1]







【図9】

